

电子行业周报 (5.20-5.26)

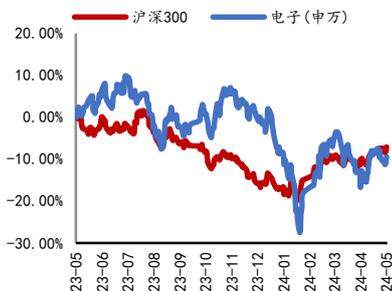
AI需求助力，扇外型面板级封装迎来机遇

强于大市(维持评级)

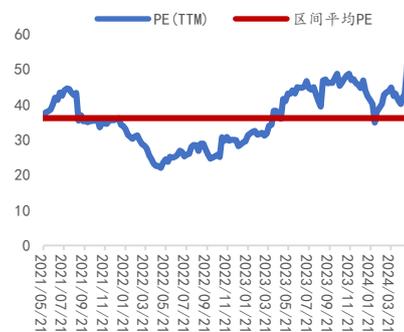
投资要点:

- 在AI/HPC等高算力需求日新月异、前段制程微缩日趋困难的背景下，先进封装已成为超越摩尔定律、提升芯片系统性能的关键途径。其中，扇外型面板级封装(FOPLP)因其独特的优势，正逐渐成为先进封装技术的一个重要分支。扇外型面板级封装可以理解为扇出晶圆级封装的延伸，其基于重新布线层(RDL)工艺将芯片重新分布在大面板上进行互连。FOPLP与传统封装方法相比，具备显著的效能提升和成本优势。例如，在可扩展性上，FOWLP(扇外型晶圆级封装)技术的面积使用率<85%，FOPLP面积使用率>95%，这使得300mmx300mm的面板比同尺寸12英寸的晶圆可以多容纳1.64倍的die；在成本效益上，FOPLP基板面积的增加可显著降低芯片制造成本，从200mm过渡到300mm大约能节省25%的成本，而从300mm过渡到板级封装，则能节约高达66%的成本。因此，FOPLP相较于传统封装具有更卓越的I/O密度和电气性能，而相较于传统的CoWoS具有更大的封装尺寸、更好的散热性能和更低的成本，能在满足AI计算对芯片性能的基本要求的同时降本增效。
- 近日传出，英伟达最快将于2026年导入扇外型面板级封装，借此缓解CoWoS先进封装产能吃紧致使AI芯片供应不足的问题。与此同时，英特尔、AMD等半导体大厂后续也将逐步加入扇外型面板级封装的阵营，且三星电子、日月光、群创等公司也正在利用现有设施和工艺能力，投资FOPLP封装技术。整体从各大厂的布局转向来看，在CoWoS产能供不应求的趋势下，面板级扇外型封装或将成为纾解AI芯片供应的利器。虽然当前FOPLP行业尚处于早期，其产业落地仍面临良率产量、供应链不完善、面板翘曲和标准化等挑战。但综合来看，AI计算的需求增长、先进封装技术的发展、成本效益的考量、技术创新的推动、市场需求的多样化等，这些因素将共同推进FOPLP的加速落地。据Yole数据显示，FOPLP市场规模将从2022年的4100万美元迅速扩大，预计在2028年将以32.5%的复合年增长率增长至2.21亿美元。随着产业链上下游厂商的不断入局，FOPLP封装的技术优势和市场需求有望充分释放，并为行业发展注入新动力。
- 投资建议:** 建议关注先进封装相关企业，如长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子、硕中科技、汇成股份等；以及封装设备相关企业，如芯碁微装、苏大维格、精智达、快克智能、光力科技、长川科技、华峰测控等；以及封装材料相关企业，如沃格光电、深南电路、兴森科技、华海诚科、联瑞新材、康强电子、艾森股份、宏昌电子、上海新阳等。
- 风险提示:** 技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；电子行业景气复苏不及预期。

一年内行业相对大盘走势



电子行业估值(PE)



团队成员

分析师 杨钟
执业证书编号: S0210522110003
邮箱: yz3979@hfzq.com.cn

联系人 詹小璿
邮箱: ZX30169@hfzq.com.cn

相关报告

- 《关注消费电子技术创新》——2024.05.20
- 《中芯华虹发布财报，营收稼动率有所回暖》——2024.05.13
- 《HBM存储战略要地，大厂加速布局》——2024.04.28

正文目录

一、	本周市场表现.....	3
1.1	电子板块本周表现.....	3
1.2	SW 电子个股本周表现	3
1.3	电子板块估值分析.....	4
二、	行业动态跟踪.....	6
2.1	半导体板块.....	6
2.2	AI 板块.....	6
2.3	消费电子板块.....	9
2.4	汽车电子板块.....	10
2.5	面板板块.....	12
三、	公司动态跟踪.....	13
四、	风险提示.....	15

图表目录

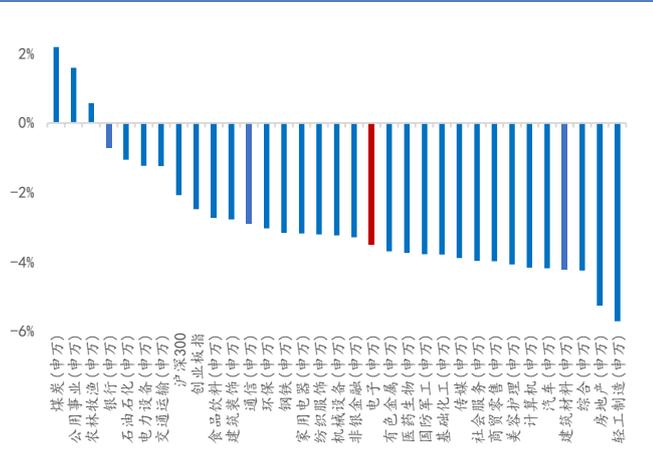
图表 1:	SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2:	电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3:	电子细分领域本周涨跌幅 (%)	3
图表 4:	SW 电子本周涨幅前十个股 (%)	4
图表 5:	SW 电子本周跌幅前十个股 (%)	4
图表 6:	SW 电子本周换手率前二十个股 (%)	4
图表 7:	SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 8:	SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 9:	过去一周股东增减持更新	13
图表 10:	过去一周股权激励一览.....	14

一、 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

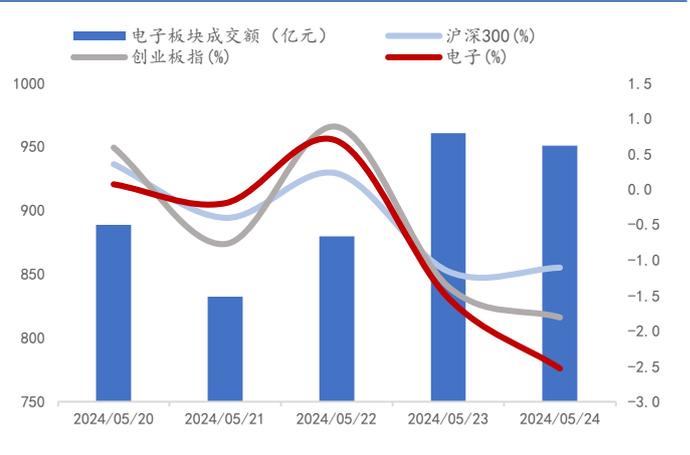
大盘表现上，本周（0520-0524）创业板指数下降 2.49%，沪深 300 指数下降 2.08%。本周电子行业指数下降 3.49%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的第 17 位，本周煤炭、公共事业、农林牧渔板块涨跌幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



数据来源：Wind，华福证券研究所

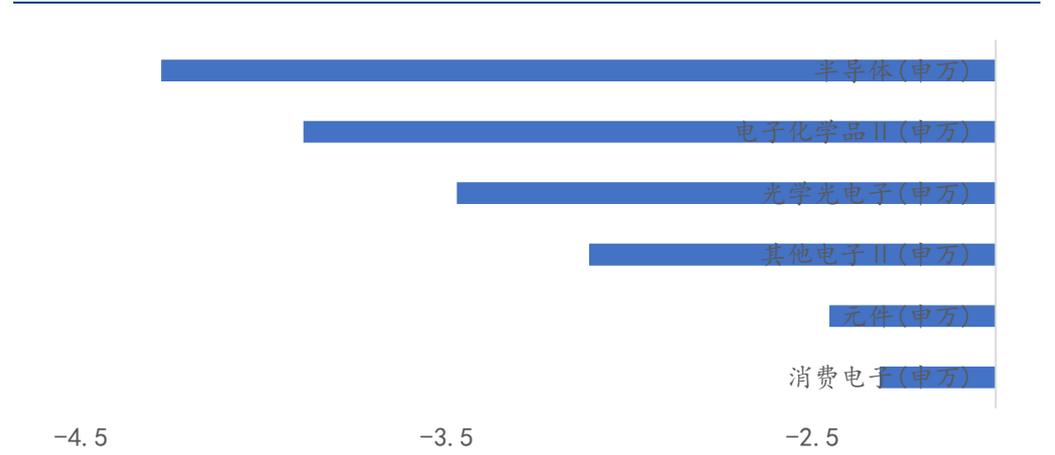
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



数据来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周电子细分板块均有所下跌。具体来看，消费电子板块跌幅最小，周涨跌幅为-2.32%，半导体板块跌幅最大，周涨跌幅为-4.28%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅（%）

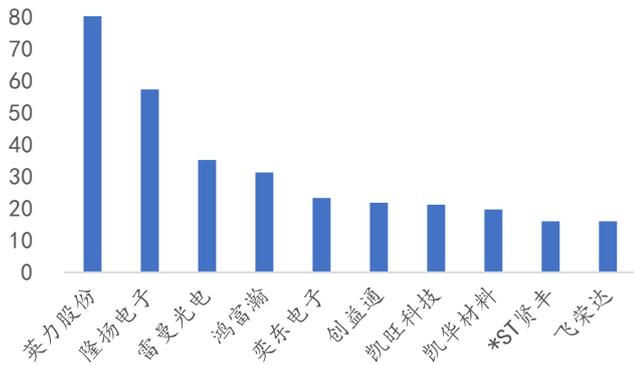


数据来源：Wind，华福证券研究所

1.2 SW 电子个股本周表现

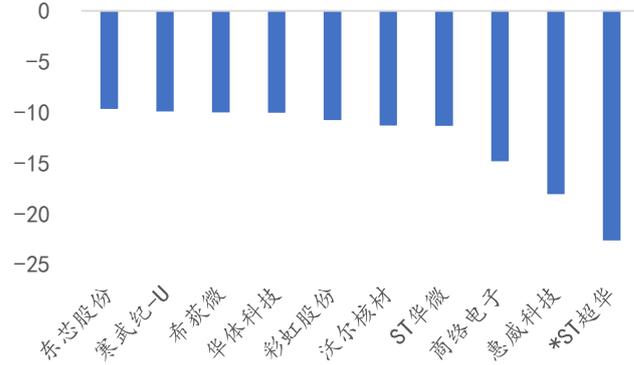
从个股维度来看，SW 电子板块中，英力股份（80.20%）、隆扬电子（57.24%）等位列涨幅前列；*ST 超华（-22.60%）、惠威科技（-18.05%）等位列跌幅前列。

图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

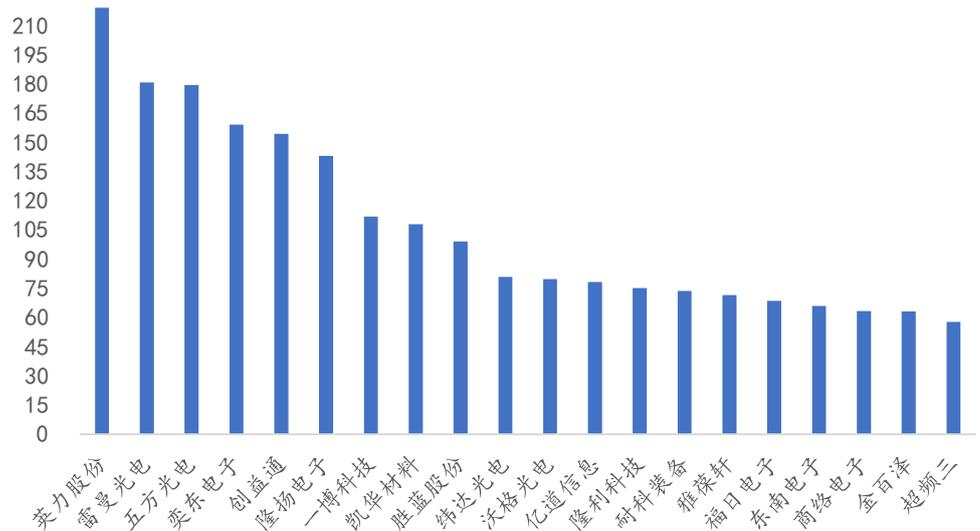
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

从换手率来看,本周电子行业个股换手率最高的是英力股份,换手率为219.10%。其余换手率较高的还有雷曼光电(180.69%)、五方光电(179.36%)和奕东电子(159.04%)。

图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%)

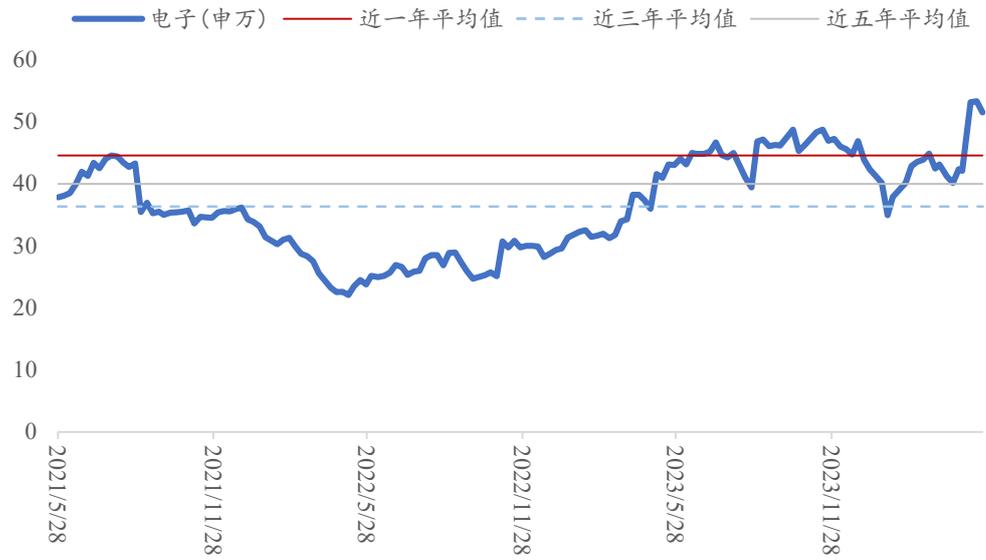


数据来源: Wind, 华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看,整体电子行业估值高于近一年、三年、五年平均值水平。本周 PE (TTM) 为 51.43 倍,较上周有所回调。

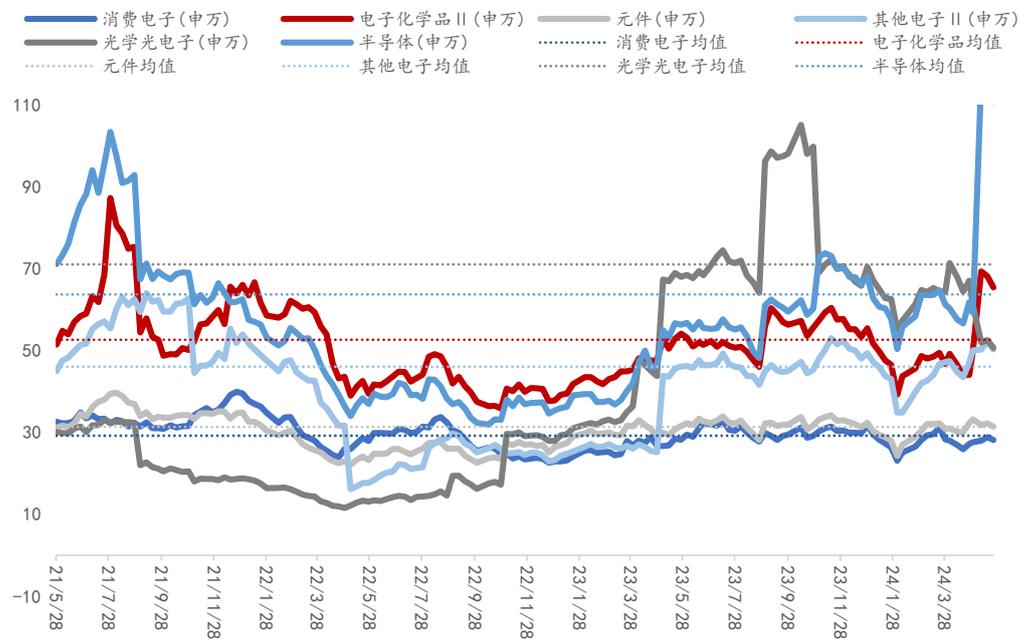
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 28.09、65.39、31.36、50.29、50.66 和 110.74。本周电子细分板块估值均有一定程度回调。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

二、 行业动态跟踪

2.1 半导体板块

1) 2024 年底前 HBM 将占先进制程比例为 35%

据市调机构 TrendForce 估算,市场对 HBM 需求呈现高速增长,加上 HBM 利润高,故三星、SK 海力士及美光国际三大原厂将增加资金投入与产能投片,预计到今年年底前, HBM 将占先进制程比例为 35%,其余则用以生产 LPDDR5 (x) 与 DDR5 产品。

以 HBM 最新进展来看, TrendForce 表示,今年 HBM3e 是市场主流,集中下半年出货。SK 海力士仍是主要供应商,与美光均采用 1 β nm 制程,两家厂商已出货英伟达;三星则采用 1 α nm 制程,第二季度完成验证,年中交货。

新厂方面,三星厂房 2024 年底产能大致满载,新厂房 P4L 计划 2025 年完工, Line 15 厂区制程转换,1Y nm 转至 1 β nm 以上;SK 海力士除了 M16 明年产能扩大, M15X 亦规划 2025 年完工,年底量产;美光中国台湾厂区明年恢复满载,后续产能扩张以美国厂为主, Boise 厂区 2025 年完工并陆续移机, 2026 年量产。

2) AMD 计划在台湾设立研发中心

AMD 正在考虑在台湾设立研发中心。据悉,AMD 已向台湾“经济部”(MOEA)提出申请,作为台湾“A+ 全球研发与创新合作计划”的一部分,建立一个新的研发机构。该合作计划涵盖三类领域,即人工智能、新一代半导体(包括高功率和高频集成电路)以及新型 5G 网络结构,旨在吸引本土和国际企业建立新的研发中心。

3) 三星已成功开发 16 层 3D DRAM 芯片

三星负责 DRAM 的执行副总裁 Siwoo Lee 近期在 IEEE IMW 2024 活动上表示,包括三星在内的一些公司已经成功制造出 16 层 3D DRAM。Siwoo Lee 说,美光已将其扩展到 8 层。

不过,该高管补充说,三星现阶段正在研究 3D DRAM 或垂直堆叠单元阵列晶体管(VS-CAT)的可行性,而不是准备大规模生产。Siwoo Lee 去年加入三星,此前曾在美光负责未来存储芯片的研究。

三星还在研究垂直沟道晶体管(VCT)。VCT 也称为 4F2,与此前技术 6F2 相比,可以将晶粒表面积减少多达 30%。Siwoo Lee 指出,原型产品将于明年亮相。

4) HBM 投资增加,美光 2024 年资本支出预测上调至 80 亿美元

美光科技小幅上调 2024 年的资本支出预测,这家美国芯片制造商大力投资生产高带宽存储(HBM)半导体,以满足人工智能(AI)行业不断增长的需求。

美光科技是 HBM 芯片的三大供应商之一,HBM 芯片是人工智能服务器所用硬件的重要组成部分。美光先进的 HBM3E 将用于 AI 芯片领导者英伟达的 H200 芯片。

美光3月份表示，HBM芯片产能在2024年已售罄，2025年可供应产能的大部分也已分配。美光目前提供8层HBM，并已开始提供12层HBM样品。

美光首席财务官Matt Murphy表示，将2024年资本支出预测从之前的75亿美元上调至约80亿美元。

5) 机构：下半年中国台湾晶圆厂产能利用率优于预期，最高达90%

研究机构TrendForce 5月22日报告表示，美国5月宣布对中国大陆进口产品加征关税，其中对中国大陆制造的半导体产品征收高达50%关税，此举将加速供应链出现转单潮，利好中国台湾晶圆代工厂。

以今年下半年情况来看，世界先进产能利用率预计将提升至75%以上；力积电将达85%~90%；联电整体产能利用率将在70%~75%之间。

机构表示，全球晶圆代工市场自2022年下半年进入下行周期，疫情导致的高库存迫使供应链花费逾一年进行修正。此后由于地缘政治、疫情等导致的转单潮，也随着产业下行放缓。随着消费电子产品库存调整进入尾声，智能手表、电视及液晶显示器所采用的TDDI、大尺寸DDI、PC MOSFET、消费型MCU等，先后于2023年第四季度起至2024年第二季度，陆续出现零部件回补订单，中国大陆、中国台湾多家晶圆厂均获急单。

6) 台积电：今年计划建设七座工厂，3nm扩充产能仍供不应求

台积电预测，全球半导体行业（不包括存储芯片在内）的年销售额将增长10%。台积电欧洲和亚洲地区销售业务高级副总裁Cliff Hou在2024技术论坛上表示，“这是人工智能（AI）的新机遇黄金时代。”

今年4月，台积电将全球半导体行业（不包括存储芯片在内）增速预期从之前超过10%的预测下调至10%左右。世界半导体贸易统计协会（WSTS）预测2024年全球半导体市场将增长13.1%。

台积电预计，随着人工智能应用半导体的需求浪潮高涨，第二季度销售额可能增长高达30%。

7) 机构：Q1中芯国际升至全球第三大晶圆代工厂，华虹第六

研究机构Counterpoint 5月22日报告显示，2024年第一季度全球晶圆代工业营收环比下滑5%，但同比增长12%，中芯国际以6%的份额升至第三名，华虹集团份额2%位居第六。机构表示，第一季度营收下滑不仅受季节性因素影响，也因为非人工智能（AI）半导体（如智能手机、消费电子、物联网、汽车和工业）需求放缓所致。

这一趋势与台积电管理层的看法不谋而合，台积电此前将2024年逻辑半导体行业的增长率预测从“高于10%”下调至约10%。

全球前六大晶圆代工企业中，台积电一季度业绩仍高居榜首，份额占比达 62% 超出预期，台积电还将 AI 相关收入年均复合增长率 50% 的持续时间延长至 2028 年。尽管预期 CoWoS 产能到 2024 年底将同比增长逾一倍，但仍无法满足客户强劲的 AI 需求。值得注意，由于 AI 芯片的强劲需求，台积电 5nm 产能利用率一直保持强劲。

8) SK 海力士：HBM3E 量产时间缩短 50%，达到大约 80% 范围的目标良率

据 businesskorea 报道，SK 海力士宣布第五代高带宽存储（HBM）—HBM3E 的良率已接近 80%。

SK 海力士生产主管 Kwon Jae-soon 表示：“我们已经成功地将 HBM3E 芯片量产所需的时间缩短 50%，达到大约 80% 范围的目标良率。”

这标志着 SK 海力士首次公开披露 HBM3E 的生产信息。此前，业界预计 SK 海力士的 HBM3E 良率在 60%~70% 之间。

Kwon Jae-soon 强调：“我们今年的目标是专注于生产 8 层 HBM3E。在人工智能（AI）时代，提高产量对于保持领先地位变得更加重要。”

9) 台积电成功开发 CFET 晶体管架构，3nm 制程今年扩增三倍

台积电资深副总经理暨副共同首席运营官张晓强在 2024 技术论坛上宣布，台积电已成功集成不同晶体管架构，在实验室做出 CFET（互补式场效应晶体管）。

张晓强指出，CFET 预计将导入先进逻辑制程以及下世代先进逻辑制程，台积电研发部门仍寻求导入新材料，实现让单一逻辑芯片容纳超 2000 亿颗晶体管，推动半导体技术持续创新。

此外，台积电成功在实验室集成 P-FET 和 N-FET 二种不同型态晶体管，做出 CFET 架构的芯片，这是 2nm 采用纳米片（Nano Sheet）架构创新后，下一个全新晶体管架构创新。

另外，负责 3nm 量产的资深厂长黄远国指出，台积电 3nm 制程今年将扩增三倍，但仍供不应求，且台积电今年还会在海内外兴建七座工厂，包含先进制程、先进封装及成熟制程，全力应对客户需求。

10) 机构：到 2029 年中国大陆半导体产能将增长 40%

研究机构 TechInsights 汇编了中国大陆半导体晶圆厂产能的信息（包括中资的和在中国大陆的跨国/地区公司晶圆厂）后，预测到 2029 年，中国大陆半导体产能将增长 40%，达到 875msi（百万平方英寸）。

TechInsights 将晶圆厂生产数据按晶圆尺寸（2、3、4、5、6、8 和 12 英寸）进行分类，半导体类型包括光电/LED、分立/电源、存储、逻辑、模拟/线性、代工厂等。TechInsights 指出，尽管 8 英寸和 6 英寸晶圆厂也有一些增长，但中国大陆半导体

产能增长将集中在 12 英寸晶圆厂。

11) 俄罗斯首台光刻机制造完成，可生产 350nm 工艺芯片

在当前国际地缘环境下，俄罗斯正在致力于推进半导体自主供应链的打造。据报道，俄罗斯首台光刻机已经制造完成并正在进行测试。

俄罗斯联邦工业和贸易部副部长 Vasily Shpak 表示，该设备可确保生产 350nm 工艺的芯片。他还称，“我们组装并制造了第一台国产光刻机。作为泽廖诺格勒技术生产线的一部分，目前正在对其进行测试。”

接下来，俄罗斯的目标是在 2026 年制造可以支持 130nm 工艺的光刻机。

2.2 AI 板块

1) 首批 Win11 AI PC：微软发布 Surface Pro/Laptop，搭载骁龙 X 芯片

微软于 5 月 21 日举办的 Build 2024 开发者前瞻大会上，正式发布全新 Surface Pro 平板电脑以及 Surface Laptop 笔记本，为首批 Windows 11 AI PC（人工智能电脑）。这两款产品搭载骁龙 X Elite、骁龙 X Plus 芯片，内置 NPU 单元，算力高达 45 TOPS（每秒 45 万亿次运算）。

微软全新 Surface Laptop 全面升级，是世界首批 Copilot+ PC 之一，微软称其更快、更智能。该产品提供 13.8 英寸、15 英寸两种规格，HDR 触控屏有着更窄边框，刷新率 120Hz。性能方面，产品全系搭载骁龙 X Elite 芯片，可高效执行工作负载，同时视频播放续航时间长达 20 小时以上。

2) 大模型激战迎来新高度 “AI 智能体” 成为新焦点

5 月，全球大模型热度激增，数得上名号的几个大模型玩家，如 OpenAI、谷歌、阿里、百度、字节、腾讯等，均一窝蜂地释出大动作，或者全面升级，或者开源免费，或者低价抢市，让原本就激战正酣的大模型市场，再掀新高潮。同时，记者也注意到，近期大模型厂商有向个人助手、智能体平台延伸的趋势，推动着其他厂商开始跟进。在长文模型、多模态之后，“AI 智能体”有望成为新的焦点。

3) 传荣耀手机即将集成谷歌 Gemini 等 AI 功能

荣耀 5 月 22 日表示，将在其即将推出的智能手机中，集成谷歌的人工智能（AI）功能，提供生成式 AI 体验。同时，新产品也将有谷歌云（Google Cloud）提供支持。荣耀发言人表示，将要集成的功能包括谷歌 AI 助手 Gemini 以及文生图工具 Imagen 2。

据悉，荣耀是少数几家承诺将 AI 引入智能手机的公司之一，2024 年 1 月，荣耀宣布与谷歌云合作，将 Gemini Pro 以及 Imagen 引入设备。2 月，荣耀推出 Magic6 系

列，其搭载了荣耀自研的 AI 功能。

4) AI PC 助力销量反弹 联想第四财季净利润 2.48 亿美元大幅超预期

联想公布连续第三个财季的利润好于预期，该公司摆脱了个人电脑和服务器需求的最低点。

由于期权和投资价值变化等项目带来的一次性收益，联想第四财季（1月-3月）净利润增长了一倍多，达到 2.48 亿美元，超过分析师平均预期的 1.584 亿美元。第四财季销售额为 138 亿美元，也高于预期的 131 亿美元。

该公司向企业提供服务器和网络设备的基础设施解决方案部门本季度收入创下新高，但净利润为亏损，联想表示，人工智能加速器供应短缺，但其他服务器设备支出疲软，尽管供应缺口“显示出缩小的迹象”。

联想截至 3 月 31 日的财年营收下降 8%，至 569 亿美元，略高于分析师预期的 561.9 亿美元。

5) 英伟达最强 AI 芯片提前报到，黄仁勋透露 GB200 已量产

英伟达执行长黄仁勋指出，其「地表最强 AI 芯片」GB200 系列现已进入量产，本季开始出货，下季放量，量产出货时程比业界预期的第 3 季甚至年底更进一步提前，市场大为惊喜。

谈到最新推出的 Blackwell 系列芯片，包括 B200、GB200 等产品，黄仁勋表示，客户正对英伟达施加庞大压力，希望该公司能快点出货，而英伟达也加足马力，相关产品已迈入生产阶段，本季会开始出货，对应客户的资料中心将在第 4 季度建成。他强调：「今年就会看到英伟达赚进大量 Blackwell 平台相关营收」。

2.3 消费电子板块

1) 机构：Q1 中东智能手机市场增长 39%，印度增长 15%

研究机构 Canalys 公布 2024 年第一季度全球各市场智能手机出货量报告。中东地区（不含土耳其）出货量达到 1220 万部，同比增长 39%，这主要得益于通货膨胀率的降低以及石油出口国对经济多元化的持续投入，带来非石油产业强劲增长。此外，该地区经济和社会改革也刺激了私营领域的投资和外籍人口增长。

Canalys 预计，在中东各地方政府致力于推动经济多元化和市场适应性的背景下，2024 年将实现高个位数的增长。厂商必须通过加强零售渠道信心、跟随政府愿景、适应消费趋势和推广可持续发展来实现长期发展。

2024 年第一季度印度智能手机市场依旧表现强劲，出货量达 3530 万部，同比增长 15%。进入 2024 年后，厂商的库存情况有所改善，这使得渠道能够承接本季度推

出的多款新品。

2) 东南亚智能手机 Q1 出货量排名出炉：传音同比增长 197%

5月24日，市场调研机构 Canalys 发布最新报告称，2024 年第一季度，东南亚地区智能手机市场同比增长 12%至 2350 万部。这是表明宏观经济已有复苏迹象，但出货量仍远低于 2023 年之前的水平。

从厂商来看，三星在东南亚保持领先地位，市场份额为 19%，但出货量同比下降 20%。Canalys 分析师周圣咏称，鉴于三星的产品战略是优先拓展中高端市场，包括 Galaxy S、A5x 和 A3x 等系列，其出货量下滑也在意料之中。虽然 A1x、A0x 和 A2x 等系列依旧是三星在大众市场的主要力量，但由于战略转变，预计未来三星的增长将会来自高端市场。

3) 分析师：苹果 MacBook 折叠屏将配备 18.8 英寸屏幕

分析师郭明錤近期表示，苹果 MacBook 将于 2026 年推出 18.8 英寸或 20.2 英寸折叠屏。现在，显示器行业专家 Ross Young 表示，该 MacBook 折叠屏设备确实将配备 18.8 英寸屏幕。

Ross Young 发布的帖子中表示，出于“成本原因”，预计苹果 MacBook 折叠屏设备将配备 18.76 英寸显示屏，而不是 20.25 英寸显示屏。郭明錤表示，在折叠状态下，18.8 英寸 MacBook 的尺寸与传统的 13 英寸或 14 英寸 MacBook 相似。

郭明錤表示，苹果的目标是让折叠屏幕“尽可能无折痕”，这可能会导致该设备的价格几乎与苹果 Vision Pro 头显一样昂贵，后者起售价为 3499 美元。他还表示，折叠屏 MacBook 将搭载苹果下一代 M5 芯片，具体型号尚未公布。

4) 传苹果 OLED iPad Air/mini 将于 2026 年开发

据报道，苹果已要求供应商为未来的 iPad mini 机型设计 OLED 显示面板。三星显示 (Samsung Display) 4 月开始为未来的 iPad mini 开发 8 英寸 OLED 面板样品，并计划于 2025 年下半年在天安工厂开始大规模生产。三星已经为苹果新款 iPad Pro 提供 OLED 面板，该面板采用串联设计，可提高亮度和能效。该报告补充称，苹果将于 2026 年为 iPad Air 和 iPad mini 配备 OLED 面板。

5) 传联想 2025 年推出新形态平板，搭载三星柔性卷轴屏

三星很早之前已经展示过一款平板电脑概念机，配备柔性卷轴屏，拉出后可扩大屏幕尺寸。近日韩国业界消息称，联想正在开发一款产品，融合平板电脑与笔记本电脑，将搭载三星的卷轴屏方案，并且支持手写笔输入。

爆料称联想这款平板默认屏幕尺寸为 13 英寸，但屏幕伸展后可以扩大至 17 英寸。分析师预计，该产品预计将于 2025 年第二季度推出，属于新概念个人电脑 (PC) 产品形态。

业界分析称三星选择提供显示屏方案，而不是自己推出 Galaxy 产品的做法较为稳妥。关于柔性屏、折叠屏设备，未来厂商需要持续探索。

2.4 汽车电子板块

1) 5月新能源汽车零售预计达77万辆 渗透率46.7%再创新高

5月24日消息，乘联会预测，本月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右，同比下降5.3%，环比增长7.5%。

其中，新能源零售预计达到77.0万辆左右，环比增长13.7%，同比增长32.7%，渗透率预计将进一步提升至46.7%。

新能源市场持续走高，4月新能源市场零售销量为67.7万辆，同比增长29.0%，渗透率达到44.1%。

分析认为，4月末汽车报废更新补贴政策的落地，一定程度上缓解了消费者观望的情绪，有利于前期压抑的消费需求逐步释放。

2) 消息称特斯拉上海超级工厂 Model Y 已减产至少 20%

路透社报道称，特斯拉上海超级工厂自3月以来已将其最畅销的 Model Y 电动汽车的产量削减 20% 以上。

中国市场目前是特斯拉仅次于美国的第二大市场，上海工厂生产的大部分汽车都在中国本地销售。随着经济形势的放缓，再加上各大电动汽车制造商都开始打起价格战，特斯拉这款老车型需求在国内出现了严重下滑。

消息人士称，特斯拉上海超级工厂计划在3~6月期间将 Model Y 的产量削减至少 20%。截至发稿，特斯拉方面仍未进行回应，不过特斯拉周四刚刚发布的最新影响力报告中已经删掉了“到 2030 年每年交付 2000 万辆汽车”的目标。

3) 小鹏汽车发布第一季度财报：营收同比增长 62.3% 毛利率大幅提升至 12.9%

5月21日消息，小鹏汽车发布2024年一季度财报。小鹏汽车一季度总收入为65.5亿元，同比增长62.3%，环比下滑49.8%；净亏损为13.7亿元，同比略有收窄，环比略有扩大；毛利率为12.9%，2023年同期为1.7%，2023年第四季度为6.2%。

小鹏汽车一季度销量为2.18万辆，环比下滑63.8%，同比增长19.8%。截至2024年3月31日，现金储备为414亿元。

4) 理想汽车 2024 年第一季度营收 256 亿元，净利润 5.911 亿元：同比下滑 36.7%

5月20日消息，理想汽车公布了2024年第一季度财报：季度营收256亿元，同比增长36.4%，环比下滑38.6%；交付量为80400辆，同比增长52.9%；净利润为5.911

亿元，同比下滑 36.7%，环比下滑 89.7%；经调整净利润为 13 亿元（扣除股权激励费用），毛利率为 20.6%。

2.5 面板板块

12) 笔记本/平板电脑 OLED 面板需求将保持 37%增长率

根据研究机构 Omdia 报告，预计 2023 年至 2031 年，移动 PC（包括笔记本电脑、平板电脑）对 OLED 面板的需求将以 37%的复合年均增长率增长，这反映了越来越多品牌在高端笔记本/平板电脑加速应用 OLED 面板的趋势。

机构预测，2024 年 OLED 屏平板电脑出货量将达到 1200 万台，OLED 屏笔记本电脑为 500 万台；而到 2027 年，两种产品的出货量将分别达到 2100 万台、2800 万台。

13) 5 月中小尺寸电视面板需求减弱 显示器延续涨势

研究机构 TrendForce 集邦咨询 5 月 20 日发布 5 月下旬面板价格评论，50 英寸以下的中小尺寸电视面板需求减弱较为明显、全面持平，大尺寸部分产品价格也出现收敛，笔记本电脑也因为第二季需求成长幅度低于预期，涨价动能不足，不过，显示器面板延续上涨态势。

机构表示，因为需求的变动，整体面板价格上涨的空间开始收敛，因此面板厂是否持续按需生产，开始积极调整稼动率来支撑面板价格的走势，将是近期观察重点。

14) 三星显示 QD-OLED 显示器累计出货量达 100 万台

韩国显示屏生产商三星显示（Samsung Display）5 月 23 日宣布，截至本月，其显示器用 QD-OLED 累计出货量为 100 万台。三星显示于 2021 年开发了世界上首款 QD-OLED 显示屏。这是一种自发光技术，其中来自蓝色 OLED 的光通过 QD（量子点）发射层产生颜色。该技术针对大型设备进行优化，具有响应速度快、色彩准确度高、近乎无限的对比度和广视角等特点。

据市场研究公司 Omdia 预计，自发光显示器面板市场将以每年 12.3%的速度增长，到 2029 年将达到 10.8 亿美元的市场规模，占整个显示器面板市场的 10%。

截至 2023 年第四季度，三星显示在自发光显示器面板市场占据 79.7%的市场份额。

三、公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	公告日期	方向	股东名称	股东身份	拟变动数量上限	拟变动数量上限 占总股本比(%)
------	------	------	----	------	------	---------	---------------------

002845.SZ	同兴达	2024-05-24	减持	上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业	股东	3,275,517.00	1.00
002845.SZ	同兴达	2024-05-24	减持	刘青科	股东	3,275,517.00	1.00
603933.SH	睿能科技	2024-05-24	减持	睿能实业有限公司	5%以上第一大股东	2,000,000.00	0.95
600666.SH	ST 瑞德	2024-05-23	增持	刘鑫	项目经理		
600666.SH	ST 瑞德	2024-05-23	增持	陈俊标	产品经理		
600666.SH	ST 瑞德	2024-05-23	增持	陈盛	财务部经理		
600666.SH	ST 瑞德	2024-05-23	增持	叶楠	内审部经理		
600666.SH	ST 瑞德	2024-05-23	增持	覃思维	项目经理		
600666.SH	ST 瑞德	2024-05-23	增持	尹瀚禹	子公司副总经理		
600666.SH	ST 瑞德	2024-05-23	增持	刘静雯	法务总监		
600666.SH	ST 瑞德	2024-05-23	增持	王彬彬	投融资总监		
600666.SH	ST 瑞德	2024-05-23	增持	易雅君	子公司总经理		
600666.SH	ST 瑞德	2024-05-23	增持	朱三高	董事,财务总监		
600666.SH	ST 瑞德	2024-05-23	增持	江洋	董事长,总经理		
688589.SH	力合微	2024-05-21	减持	陈金城	5%以上非第一大股东	900,000.00	0.89
688036.SH	传音控股	2024-05-21	减持	深圳市传音投资有限公司	股东	8,065,652.00	1.00
688268.SH	华特气体	2024-05-25	减持	厦门华弘多福投资合伙企业	5%以上非第一大股东	1,300,000.00	1.08
688268.SH	华特气体	2024-05-25	减持	厦门华和多福投资合伙企业	5%以上非第一大股东	680,000.00	0.56
688268.SH	华特气体	2024-05-25	减持	厦门华进多福投资合伙企业	5%以下股东	420,000.00	0.35
301359.SZ	东南电子	2024-05-22	增持	仇文奎	控股股东,实际控制人之一,董事长,总经理		
605277.SH	新亚电子	2024-05-23	减持	海南历信创业投资合伙企业	5%以上非第一大股东	2,644,919.00	1.00
688173.SH	希荻微	2024-05-24	减持	宁波梅山保税港区泓璟股权投资合伙企业	5%以上非第一大股东	8,195,014.00	2.00

数据来源: Wind, 华福证券研究所

图表 10: 过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数(万)	激励总数占当时总股本比例(%)	期权初始行权价格
600183.SH	生益科技	2024-05-22	董事会预案	上市公司定向发行股票	5,893.89	2.4926	10.49
688210.SH	统联精密	2024-05-25	董事会预案	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	471.31	2.9730	10.70
300782.SZ	卓胜微	2024-05-20	股东大会通过	上市公司定向发行股票	107.90	0.2021	54.00
301297.SZ	富乐德	2024-05-24	股东大会通过	上市公司定向发行股票	825.00	2.4380	10.80
603228.SH	景旺电子	2024-05-21	股东大会通过	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	755.79	0.8977	15.82
603228.SH	景旺电子	2024-05-21	股东大会通过	上市公司定向发行股票及上市	1,484.11	1.7629	9.89

公司提取激励基金买入流通股

股票代码	公司名称	日期	事项	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	120.00	1.4400	17.72
688325.SH	赛微微电	2024-05-22	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	120.00	1.4400	17.72
688352.SH	硕中科技	2024-05-24	实施	上市公司定向发行股票	3,567.11	3.0000	6.25
688458.SH	美芯晟	2024-05-22	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	150.00	1.8748	29.11
688593.SH	新相微	2024-05-23	股东大会通过	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	720.00	1.5668	7.10
300576.SZ	容大感光	2024-05-20	实施	上市公司定向发行股票	298.80	1.0105	16.71
688325.SH	赛微微电	2024-05-22	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	120.00	1.4400	17.72
688352.SH	硕中科技	2024-05-24	实施	上市公司定向发行股票	3,567.11	3.0000	6.25
688458.SH	美芯晟	2024-05-22	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	150.00	1.8748	29.11

数据来源: Wind, 华福证券研究所

四、 风险提示

技术发展及落地不及预期; 下游终端出货不及预期; 下游需求不及预期; 市场竞争加剧风险; 地缘政治风险; 电子行业景气复苏不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn